

SEMICON® JAPAN 2025

@東京ビッグサイト 南ホール入り口すぐ

ブースNo. **S1104**

ぜひ当社ブースにお越しください。
皆様のご来場をお待ちしております。



ご案内はこちら



はくまく 薄膜技術

で
世界の産業科学に
貢献する。

半導体製造装置の
サムコ株式会社
samco
PARTNERS IN PROGRESS

〒612-8443 京都市伏見区竹田薬屋町36 TEL:075-621-7841

創造を止めるな。 想像を超えろ。

世界を変えるきっかけは、私たちが創り出す。





<https://www.jsr.co.jp>

SEMICON Japan 推進委員会 委員長

瀬川 澄江



本日開幕するSEMICON Japan 2025のテーマは「AI×サステナビリティ×半導体」です。気候変動やエネルギー供給、地政学的変化など、人類がさまざまな世界規模の困難に直面する中で、よりよい未来の創造に向けて、AIの進化、デジタルソリューション活用への期待が高まっています。AI社会の基盤技術となる半導体は、ますますその重要性が高め、日常に欠かせない存在であり、社会インフラそのものになりました。

今回のSEMICON Japanでは半導体そのものを作り出す力、半導体のさまざまな用途での活躍を皆さんそれぞれが、見て、聞いて、感じる事ができるイベントを目指して、これまでになく大規模なものとなりました。

出展各社によるブース展示に加え、特設ステージでの基調講演やセミナーを多数開催する予定です。人と人が直接向き合い、会話を交わしながらビジネスを進めるといふ展示会本来の意義を、来場者と出展者の双方の皆さまに強く実感していただけると確信しております。

大学研究室の活動をブース展示する「アカデミア」、全国各地の高等専門学校による研究展示に加え、新たに、高専生による回路設計のスピードを競うイベントも行われます。産業界で活躍する女性たちが現状と課題を議論するセッションを本年も開催します。

多くの皆さまに、この業界の持つ熱気とスピード感を肌で感じていただきたく、会場でお会いすることを心待ちにしております。

熱気・スピード…体感

SEMICON Japan 代表取締役 浜島 雅彦

ごあいさつ



今年も注目企画が目押しです。世界中から300人の業界トップリーダーが東京ビッグサイトに集結し、さまざまなテーマで半導体産業の現在の課題と未来のビジョンを語ります。この先の半導体産業の未来を見て、感じて、感じていただける充実した内容で皆さまをお待ちしています。

今年には新たに二つのサミットを立ち上げました。

「AI×サステナビリティ×セミコンダクター・サミット(AISS)」では、人工知能(AI)と半導体技術の革新による持続可能な未来をテーマに、エネルギー効率向上や排出削減、サステナブルなサプライチェーン(供給網)など、最先端課題に挑みます。「メトロロジ・アンド・インスペクション・サミット(MIS)」では、検査・計測分野にフォーカスし、品質と信頼性を支える技術を深掘りします。

さらに、西4ホールの特設スペース「SuperTHIEATER」では、Apple、NVIDIA、Intel、TEL、AMATなど、世界をけん引する企業のトップエグゼクティブが登場し、70超の注目トピックス、10以上のステージで半導体技術、エンジニアリング技術、アプリケーション技術、制作・市場、人材開発(WFD)など多様な

半導体の未来—共に創る

切り口で業界最前線を網羅するセミナーを開催します。次世代を担う人材育成にも力を入れています。新企画「SEMI THURSDAY「WAKAMONON」IGH」を18日16時から開催。学生や若手社会人が、楽しみながら半導体学習、業界関係者と交流できる場を提供します。

また、産官学連携で人材育成を議論するシンポジウム、合同説明会形式の「未来COLEGE」、全国の研究室成果を発表する「アカデミア」、高等専門学校生によるアイデア展示「THIE高専」、若手社会人が企業の枠を超えて挑戦するハッカソン「TECH CAMP」など多彩な企画を用意しました。

このほか、紙面で紹介しきれないほどの内容を通じ、最先端のテクノロジーと最新のビジネストレンドを吸収できる機会をご用意しています。半導体産業の未来を共に創る場へ、ぜひご来場ください。

SEMICON JAPAN

きょう開幕

半導体製造サプライチェーンの国際展示会「SEMICON Japan (セミコンジャパン) 2025」が17日から19日までの3日間、東京・有明の東京ビッグサイト東展示棟・西展示棟・南展示棟で開催する。主催はSEMIジャパン。

今年は「AI×サステナビリティ×半導体」をテーマに、検査・計測技術に特化した「メトロロジ・アンド・インスペクション・サミット(MIS)」などの新企画とともに、幅広く半導体産業を紹介する。開場は10時から17時まで。入場は無料(事前登録制)。セミナーは一部有料。

半導体—最前線

12月17日—19日 / 東京ビッグサイト

田中貴金属

可能性、

ゾクゾク。



資産用の貴金属に宝飾品はもちろん。半導体、水素社会、メディカル分野などで使われる貴金属素材。持続可能な未来をつくるリサイクルにも。身近なところから最先端の領域まで。貴金属にしかつくれない未来があります。

可能性、ゾクゾク。田中貴金属

株式会社田中貴金属グループ 〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町2-6-6

<https://tanaka-preciousmetals.com>



KOFLOC
Kyoto

SEMICON[®] 東京ビッグサイト
JAPAN 東5ホール E5702

流体計測・制御技術のコフロック

温度補正付小型カルマン渦流量計
MODEL FML-300 SERIES

純水/薬液
対応

温度センサ搭載により、
液温変化時にも高精度な流量計測

- 温度補正により液温変化による精度誤差軽減
- 接液部NewPFAのみのオーリングレス設計
薬液や純水にも対応
- 0.3~250L/minまでの幅広い流量に対応
- 流量出力のほかに温度出力と警報出力あり
- RS485通信対応
- コンパクト設計で装置の小型化にも貢献
- IP65相当の防水性

PIマスフローコントローラ
MODEL ST-500 SERIES

腐蝕性ガス
対応

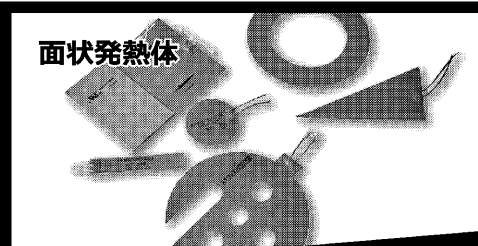
圧力センサ搭載により、
圧力変動時にも安定した流量制御

- PI…Pressure Insensitive (ST-500のみ)
圧力変動に対し安定した流量制御
- 制御範囲 (N₂) : 2SCCM~30SLM
- メタルシール、EP処理、酸化被膜処理
- DeviceNet[®]/EtherCAT[®]/RS485通信
(ST-550のみ)
- ガスパネルマウント Wシール/Cシール兼手対応
- S.P.精度、全流量制御応答1sec以内
- マルチレンジ機能 (30~100%F.S.)

コフロック株式会社
<https://www.kofloc.co.jp>

本社・京田辺工場 〒610-0311 京都府京田辺市草内堂ノ木1-3
八幡オフィス・工場 〒614-8184 京都府八幡市上津屋八丁25
東京メインオフィス 〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町3-3-6 人形町7F・2F
名古屋オフィス 〒450-0002 名古屋市中村区名駅5-16-17 花車ビル南館8F
大阪オフィス 〒564-0063 大阪府吹田市江坂町1-23-20 TEK第2ビル8F
九州出張所 〒839-0812 福岡県久留米市山川安居野3-12-7 オイルハウス久留米

TEL:0774-62-4411 FAX:0774-63-5041
TEL:075-983-3500 FAX:075-983-3501
TEL:03-3664-0200 FAX:03-3664-0210
TEL:052-583-0411 FAX:052-569-1286
TEL:06-4861-4441 FAX:06-4861-4455
TEL:0942-41-0088 FAX:075-983-3501



面状発熱体



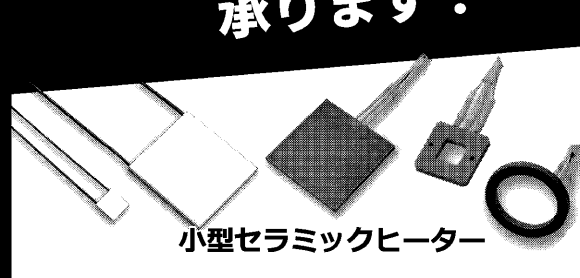
カートリッジヒーター

UL認証も対応可能！

詳細はお問い合わせください

オーダーメイド 承ります！

熱 のことならお任せください！



小型セラミックヒーター



エミファインシリーズ
(断熱材・ジャケットヒーター)

省エネ 軽量！

20%
省エネ
※

30%
軽量
※

※弊社従来品
(断熱材)と
比較した場合

未来を拓く、電熱技術



坂口電熱

営業本部

03-5624-5054

東5ホール

E5501

SEMICON® JAPAN



SEMICON JAPAN

A I × サステナビリティ × 半導体

半導体装置11%増

世界第3四半期



SEMICON JAPAN 2024の会場内。多くの来場者が展示物を観覧している様子。

SEMICON JAPAN 2024の会場内。多くの来場者が展示物を観覧している様子。

APCS

「アドバンスドパッケージング・アンド・チップレット・サミット (APCS)」は後工程技術に特化した専門展示会だ。半導体パッケージングはアプリケーションによって求められる要件が異なる。小型化や低消費電力、高信頼性、低コストなどさまざまなニーズがある。これらには2×x次元 (2×xD) や3D、再配線層 (RDL)、シリコン貫通電極 (TSV)、チップレット、新たな設計手法、シミュレーション環境などの掛け合わせが必要となる。

APCSでは業界をリードする主要企業が後工程に関連した最新技術やソリューションを披露する「展示エリア」や、業界のキーパーソンが登壇し先端パッケージ技術の未来像を探る「カンファレンス」を実施する。このほか、半導体パッケージングの基礎編から最新の技術について2部構成で解説する「最先端チップレット製造工程など注目技術が紹介された」 (SEMICON JAPAN 2024)。

ADIS

次世代の半導体設計と検証分野にフォーカスするサミット。「アドバンスドデザイン・イノベーション・サミット (ADIS)」を昨年に続き開催する。最終フロアクトのシステム構成には、より使いやすい快適なソフトウェアと、それを実現させる半導体が求められる。システム全体の設計、検証分野が注目される。展示エリアとカンファレンス、交流の場「ネットワーキング」で構成する。

MIS

「マイクロジョー・アンド・インスペクション・サミット (MIS)」は半導体製造における検査・計測技術に特化した初開催のサミット。AI時代の進展を支える半導体製造では、微細化やチップレットなどの集積技術が加速しており、高度な検査・計測技術が欠かせない。出展エリアのほか、デバイス・検査装置メーカーとトップアナリストが半導体検査計測の未来を多角的に議論するカンファレンスや事前登録制のネットワーキングで構成する。このほか、AI半導体とAIプラットフォームなど、持続可能性を支える最先端技術が集結する「AI×サステナビリティ×セミコンダクター・サミット (AI×S)」も初開催する。

WSEMS

世界第3四半期の世界半導体製造装置市場統計 (WSEMS) によると、最大市場の中国向けの売り上げは、145億6000万ドル (前年同期比13%増) だった。世界販売における中国市場の比率は43%と四半期ぶりに4割を超えた。台湾は82億1000万ドル (同75%増) と大きく伸び、韓国も50億7000万ドル (同12%増) と好調だった。日本は同5%増の18億3000万ドルとなった一方、北米は同52%減、欧州が同50%減となった。

SEMIIが11月に発表した世界シリコンウエハー出荷面積について、25年第3四半期は33億1300万平方インチ (前年同期比3.1%増) となった。主に先端ロジックやクラウドインフラ、メモリ向けの需要拡大に

世界第3四半期

より300μmのウエハーの出荷量が増加傾向という。ウエハーの需要の成長の背景には、AIによる先進プロセスへの投資拡大があるとした。

シリコンウエハーは半導体の基本的な材料。高度な技術でつくられた薄い円盤状の素材で、最大300μmまでのさまざまな直径で製造されている。ほとんどの半導体デバイス (チップ) の基板材料として使われている。こうした中、SEMICON Japan 2025は過去最大規模の出展者数となり、AI時代を見据えた新企画を盛り込むなど見どころが満載だ。

多くの関心を集めた半導体の製造工程のパネル展示 (SEMICON Japan 2024)。

SEMII

SEMIIは半導体製造装置の販売額が増加した背景として、AIコンピュータ向け向けの先端ロジック、DRAM、パッケージングソリューションなど先進テクノロジーへの旺盛な投資がけん引したとしている。また、中国向けの半導体製造装置の出荷が顕著に増加したことによって、全体的な好調につながった。

世界第3四半期

より300μmのウエハーの出荷量が増加傾向という。ウエハーの需要の成長の背景には、AIによる先進プロセスへの投資拡大があるとした。

シリコンウエハーは半導体の基本的な材料。高度な技術でつくられた薄い円盤状の素材で、最大300μmまでのさまざまな直径で製造されている。ほとんどの半導体デバイス (チップ) の基板材料として使われている。こうした中、SEMICON Japan 2025は過去最大規模の出展者数となり、AI時代を見据えた新企画を盛り込むなど見どころが満載だ。

多くの関心を集めた半導体の製造工程のパネル展示 (SEMICON Japan 2024)。

YASKAWA

半導体アドバンスパッケージ技術に対応!

先端半導体製造を革新する YASKAWAのデータソリューション

高精度・低振動な搬送を可能にするロボット・モーションコントロール製品に、お客さまの止まらない生産を実現するデータソリューションを加え、ますます高付加価値化が求められる半導体製造の課題解決に貢献します。

低振動搬送システム+超高精度ステージ+データソリューション

中工程向けのノンストレスなワーク搬送システムと超高精度ステージによる実演機を展示します。EFEM、ハイブリッドボンディングへ適用でき、データ活用による半導体製造の完全自動化をも見据えています。当社のソリューションコンセプト「i³-Mechatronics」を体現した先進技術のデモンストレーションです。

大気環境向け半導体ウェハ搬送用ロボット
SEMISTAR-GEKKO MD124D

省エネと小型化を両立したモータ・インバータのセンシング機能

小型・軽量化とIE5基準の高効率運転を実現した「エコPMモータフラットタイプ」と小型高機能インバータ「GA500」によるセンサーレス異常検知の実演です。機械の省エネ、小型化と安定稼働を実現するソリューションです。

小型・高機能インバータ GA500

エコPMモータ
フラットタイプ

異常検知機能による予防保全

ACサーボドライブΣ-Xの変化点検知機能で異常予兆の把握や予防保全、ダウンタイムの短縮をご提案するデモンストレーションです。

マシンコントローラ
MPX1310

ACサーボドライブ
Σ-Xシリーズ

SEMICON[®] JAPAN

会期 2025年12月17日(水)~19日(金) 10:00~17:00

会場 東京ビッグサイト 南展示棟

こちらからご登録ください

本展への入場には、
事前登録が必要です。

株式会社 安川電機

営業本部 半導体営業統括部

TEL : 03-5402-4546 FAX : 03-5402-4408

オフィシャルサイト <https://www.yaskawa.co.jp>

製品・技術情報サイト <https://www.e-mechatronics.com>

フッ素樹脂加工・精密切削加工

◀フッ素樹脂成形・専用射出成形機 110 ton▶

・半導体装置用途

・理化学機器用途

汎用樹脂
エンブラ
金型/成形

ウエハ搬送用トレイ
規格品あります

◀半導体製造装置向け精密金属部品加工▶

フッ素樹脂切削も加わりました

精密切削加工は

●アルミ ●アルミダイキャスト

●真鍮 ●鉄 ●その他

難削材の高精度部品加工

5軸加工機 15台

を含むMC76台

NC 10台

東6Hall 製造イノベーションパビリオン

ブースNo. **E6237**

ラヤマバック

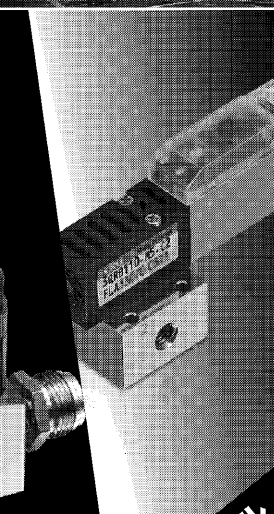
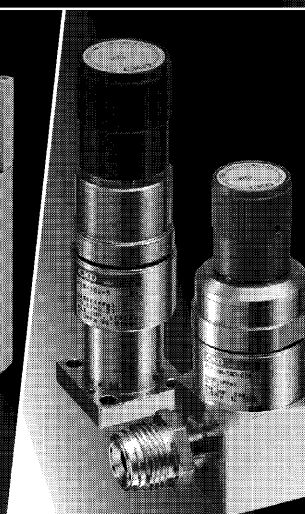
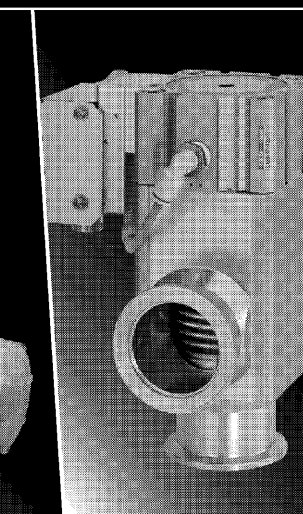
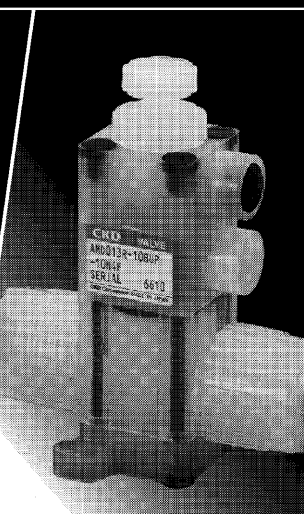
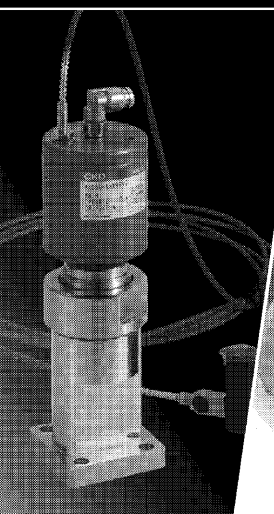
TEL 03-3695-6011

info@rayama.co.jp

※帯電防止用PET製

お問合せはこちら

CKD 次世代半導体プロセスへの共創



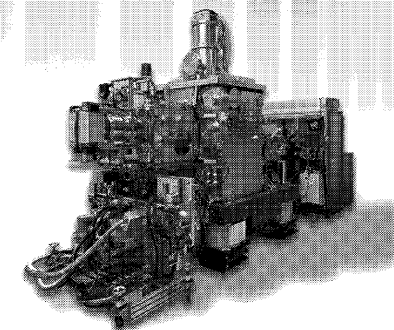
CKD株式会社

〒485-8551 愛知県小牧市応時2-250
TEL (0568)77-1111
https://www.ckd.co.jp

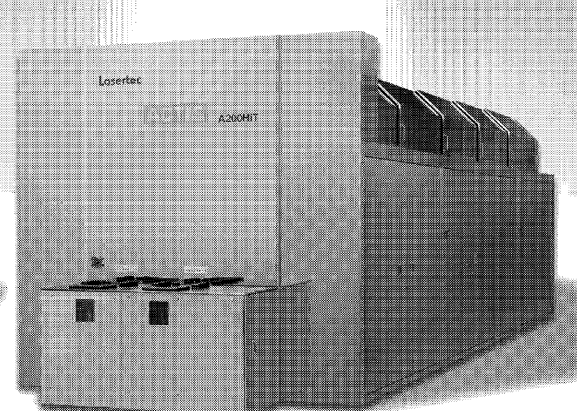
SEMICON JAPAN

南1ホール S1505

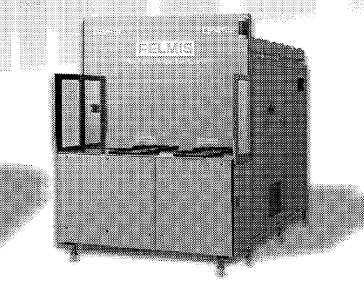
Solutions for EUV mask and mask blanks



ABICS シリーズ E320
High NA EUVリソグラフィに対応した
次世代モデル



ACTIS A200HiT シリーズ
EUVマスク転写性欠陥を高速・高感度で捉える
ウェハファブ向けハイスループットモデル



PELMIS シリーズ
ベリクル付きEUVマスクの
ベリクル検査に対応

NEW

SEMICON JAPAN
レーザーデックは SEMICON JAPAN 2025 に出展します

2025年12月17日 19日 日
東京ビッグサイト 南棟1F #S1423

SEMICON JAPAN

SPECIAL FEATURES

THE高専 研究発表

高等専門学校高専は大学と同じ高等教育機関で、15歳から5年間専門教育を行う。本科卒なら20歳で社会に出る高専生は、身につけたスキルと行動力、論理的思考力を武器にモノづくりや情報通信などさまざまな分野で活躍している。

●独創性
出展企業がスポンサーとなり、高専10校が参加する「THE高専」が東6ホールで開かれる。モノづくりに意欲的な高専の学生に研究成果発表機会を提供し、職業意欲の醸成、将来を見据えた業界研究促進、企業と高専との交流活性化を目的にする。参加校はブースを通じて独創性がある研究を発表する。

●コンテスト
高専生を対象にしたコンテストも実施する。「SEMI Circuit Design Contest」は有明高専が開発協力を発表する。

未来担う 人材育成

SEMICON JAPANは業界の今後を担う若手世代の応援プログラムを複数実施する。

●合同説明会
「未来COLLEGE @SEMICON JAPAN 2025」は合同説明会形式のプログラム。半導体関連企業58社が参加する。事前予約優先のブースアワーは、1グループ最大15人で約1時間かけて出展ブースをツアー形式で巡る。

●座談会
座談会「すごいぞ！半導体業界の仲間たち」では、各社で活躍する営業・技術・人事などさまざまな未来COLLEGEの座談会（SEMICON Japan 2024）

夜も！ セミコン

●木曜夜！会議棟
「SEMITHURSDAY WAKAMONONIGHT」は18日（木）16時から20時半まで会議棟で開催する、夜までセミコンを楽しむことができる初のイベント。学生や若手社会人を対象に、半導体業界のトップリーダーによるトークセッションなどを行う。

●ものづくり太郎氏
「トークセッションSEMICONレジェンドトーク」では、ものづくり太郎氏（製造業系YouTuber）がゲストを迎えて、特別セッションを行う。ラピダス社長兼CEOの小池淳義氏と京セラ社長取締役の須永順子氏がゲスト出演する。業界の最新線を知るトップリーダーが等身大の言葉で語る。

●成田悠輔氏
「成田悠輔の情熱ラボ」は経済学者の成田悠輔氏が「AIと社会の未来」「未来の働き方と社会のかたち」「情報社会と信頼・意思決定」「テクノロジーと人間らしさ」などをテーマに参加学生たちと対話する。

●社会人＆学生
このほか、「WAKAMONONCONNECTION」では、若手社会人と学生がチームを組み、アイスブレイクやゲームを交えたテーマトークなどで交流を図る。半導体業界に興味がある学生には直接リアルな話を聞くことができるチャンスとなる。夜のブースツアーなども開催する。

ファストパス

出展企業の採用意欲も高い。「SEMIFASTパスプログラム」はSEMICONに来場した学生を対象にした制度。制度への参画企業にレポートを提出することで、新卒採用の選考に関して、選考免除などの特典を受けることができる。



「THE高専コーナー」
(SEMICON Japan2024)



前工程から後工程まで半導体製造を支える確かな技術

微細化／3次元実装技術／アドバンスドパッケージング

シンフォニアのクリーン搬送システム 半導体

SEMICON JAPAN 東4ホール No.4732

200mm SMIFロードポート

300/200mm 自動切換ロードポート

300mm EFEM

Tape Frame FOUP ロードポート

Panel FOUP ロードポート

Panel 搬送 AMRシステム

響いてこそ技術

SINFONIA

シンフォニアテクノロジー 株式会社

東京本社 / 〒105-8564 東京都港区芝大門1-1-30 芝NBFタワー TEL 03-5473-1838

シンフォニアテクノロジー 検索

JCU

「表面」の進化が未来を彩る。



表面処理技術から未来を創造する

Explorer in Surface Engineering

私たちは、創業以来、装飾・防錆めっき技術から発展した様々な表面処理技術の提供で、自動車、エレクトロニクスなどの産業の成長を支えてきました。これからも、長年培った知見と研究・開発力で、新たな表面処理技術を追究し、ものづくりを支え、世界中の人々の豊かな生活に貢献します。

株式会社 JCU

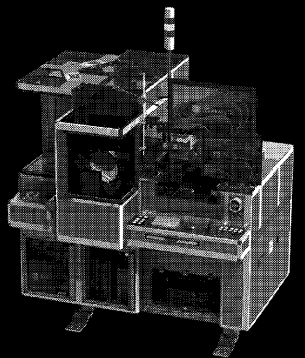
https://www.jcu-i.com/

本社：〒110-0015 東京都台東区東上野4-8-1 TIXTOWER UENO 16階 TEL：03-6895-7001 FAX：03-6895-7021

国内拠点：本社 大阪支店 九州営業所 名古屋支店 総合研究所 生産本部 熊本事業所

海外拠点：中国 台湾 韓国 メキシコ アメリカ ベトナム タイ インドネシア インド マレーシア

“世界にないもの”を
創り出す



SEMICON JAPAN 2025
W-2716(伊藤忠マシンテクノス ブース) 西館 1F

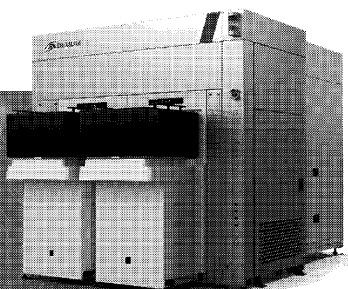
アテル株式会社

〒721-0957 広島県福山市真島町4817番地9
電話番号:(084)971-7010 FAX:(084)953-5330
https://atel-corp.co.jp/





ハイブリッドボンダ
TFC-6800



パネル用ウェットスピン装置
PD-series

・サーバや生成 AI に用いられる GPU や HBM、
イメージセンサ分野に最適な超高精度を実現
・ダブルヘッド構成による高い生産性を実現
・ハイブリッド & フュージョンプロセスに最適な Clean class1* を実現

・ウェーハ前工程レベル × 大型の角型ワークのプロセス技術
・多様なワーク対応
※□300～□600 (mm) 対応。有機基板、ガラス/RDL、角型 Si ウェーハ等。
・高洗浄度洗浄・エッチング等各種ウェットプロセス対応
・開発・研究向けの柔軟なユニット構築。量産展開対応

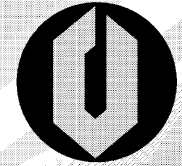
SEMICON JAPAN 2025 に出展します

■総合ゾーン 南 Hall2 小間番号 S2408
■APCS プロムナード 東 Hall6 小間番号 E6045

芝浦メカトロニクス株式会社
〒247-8610 神奈川県横浜市都筑区登戸 2-5-1
https://www.shibaura.co.jp/



SEMICON JAPAN
東4ホール E4407



UYEMURA

めっき技術で
最先端のものづくりに
貢献する



表面処理技術のリーディングカンパニー

上村工業株式会社

■大阪本社 〒541-0045 大阪府大阪市中央区道修町 3-2-6 TEL: 06-6202-8871
■東京支社 〒103-0011 東京都中央区日本橋大伝馬町 12-7 TEL: 03-5645-2525
■名古屋支店 〒451-0044 愛知県名古屋市中区菊井 1-20-11 TEL: 052-571-5381
■海外 米国、香港、深圳、上海、台湾、韓国、シンガポール、マレーシア、タイ、インドネシア



https://www.uyemura.co.jp/

SEMICON JAPAN

有力企業の製品・技術 順不同

安川電機

安川電機は「先端半導体製造を革新する YASKAWA のデータソリューション」をテーマに出展。
高精度・低振動な搬送を可能にする水平多関節ロボット「SEMI-STERGEEK OM-D124D」やモーションコントローラ製品に、お客さまの止まらない生産を実現するデータソリューションを加え、半導体製造のさらなる自動化、高精度化、高付加価値化に貢献するソリューションを提案する。
また、省エネルギー化と小型化を両立したモーター・インバーターによるセンサレス異常検知の実演や、異常予兆の把握と予防保全、ダウンタイムの短縮提案のデモンストレーションなど多くの見所がある。

アテル

アテルは長年半導体製造分野のクリーン搬送技術を培ってきた。この技術を基に薄型ウエハーや大きな反りのあるウエハーなど、特殊なウエハーを扱える検査装置やレーザーマーカー複合検査装置、各種ローダーなどを開発・設計、製造、販売している。
独自の板金技術駆使することにより、従来品より低コストで装置を製作できる。新しく開発したソフトウエアを用いて、ウエハーの表面の目視観察、顕微鏡拡大観察、レビュ観察などを組み合わせたことも可能。ユーザーのカスタムオーダーに応じて独自仕様で装置を仕上げる。
今後も、顧客満足度の高い装置の開発に力を注ぐ。

奥野製薬工業

奥野製薬工業はガラスへの高密着めっきプロセス「TORIZING (トライジング) プロセス」とガラスコーティングスルーパーライニング硫酸銅めっき添加剤「トッパルチナ GCS シリーズ」を 515^{mm}×510^{mm} 以上のガラス基板とともに展示して紹介する。
また次世代パワー半導体「ルチル型」酸化ゲルマニウム (r-GeO₂) の実用化・普及を目指す Patentix (滋賀県草津市) が開発するミニスト CVD 装置を初出展。ブース内で霧化をデモンストレーションする。
そのほか、Cu-Cu ハイブリッドボンディング用硫酸銅めっき添加剤「TORYZA LCN LXD」も合わせて訴求する。

理研計器

理研計器は産業用ガス検知警報器の総合メーカーで、研究から開発、生産、販売、メンテナンスまで自社で行う。創業 86 年で培った高い技術力を強みに、国内はもとより、グローバルカンパニーとしての地位確立を目指す。
展示会では新製品の半導体工場向け定置型ガス検知部「GD-81D」を出品する。新開発の M センサーユニットにより 1 台で最大 2 成分を同時に検知可能。会場では内部構造を見直した静音ポンプも体感できる。国内外へ積極的にアピールを行う。
また、ガスセンサーを 4 種類まで搭載できる「GD-84D」や、大規模工場の集中監視に適したガス総合監視システム「理研計器監視 II」も紹介。

西村ケミテック

「新たな価値創造」を掲げる西村ケミテックは半導体・電子デバイス産業向け最新装置の提案と、国内未紹介の海外新商材を展示する。
高精度な薬液希釈混合システムと分析器を一体化できる新たなシステムを提案。そして原液送液、充填ドラムキャビネットの完全自動化の進化型を提案する。完全自動化は原液送液・充填時の誤操作や誤接続、誤充填を防ぐ。
また、再検査ゼロを目指す AI (人工知能) 搭載外観検査装置など、次世代製造を支える革新的ソリューションも紹介する。会場では新技術を用いた未来の製造現場を体感できる。

サムコ

サムコは、次世代デバイス生産向け技術を提案する。高度化する半導体製造にあわせて強化した原子層レベルの精密加工を実現する ALD (原子層エッチング) / ALD (原子層堆積) 装置のほか、光電融合を見据えたインプレーザーやフォトリソニック結晶の最新加工技術を紹介する。
SiC / GaN パワーデバイス対応クラスターツールシステム「クラスター H」やプラズマ CVD 装置「PD-2200 LCC」や、ウエハー枚板式「Aqua Plasma」装置を展示。チップレット向け 600^{mm} 角基板対応のプラズマ装置も紹介する。18 日 16 時からハッピーアワーでは松井で京都伏見の日本酒を振る舞う。

田中貴金属

田中貴金属は 1885 年の創業以来、貴金属のプロフェッショナルとして世界の製造業と共に歩んできた。
半導体はスマートフォンやパソコンなど、さまざまなデジタルデバイスや社会インフラに組み込まれ、私たちの暮らしに欠かせない。同社の素材は汎用チップから最先端チップまで、あらゆる半導体で使われている。貴金属素材のポテンシャルを最大限に生かした先端素材の提供と、長年の製品開発で培った技術力で、コスト削減とリサイクルに貢献することを使命とする。これからは貴金属を核とした先端素材の開発と安定供給を通して、ゆとりある豊かな社会の実現と美しい地球の未来に貢献していく。

芝浦メカトロニクス

芝浦メカトロニクスは半導体やフラットパネルディスプレイ (FPD) などの製造装置を開発からサービスまで提供している。会場では枚葉式のウェット/ドライ各種装置やフォトリソ製造装置、最先端パッケージ向けボンダーなどソリューションを提案する。
前工程ではパネル用ウェットスピン装置として、次世代パッケージ向け 3000^{mm} 600^{mm} 角など大型パネル対応の「PD-series」を紹介。
後工程では最先端パッケージ分野に適合し、高精度、マルチプロセスタイプ対応で顧客に貢献する新製品「TFC-6500 W」を展示。多種多様な製品やプロセスに対応する真空成膜装置も紹介する。

今日ない価値を、
明日には創る。

会期:25年12月17日(水)~19日(金)
10:00-17:00
会場:東京ビッグサイト

小間番号
W2835(西2ホール)

来場登録はこちら


SEMICON JAPAN

SEMICON JAPAN2025に出展します

出展案内

NYSから新たな装置提案

データ集積(薬品、Slurry)への提案
・様々な分析・解析器と連結し製造データの集積を可能とする高性能システム
(液中パーティクル、高精度濃度、その他システム)

Factory Automation化への提案
・原液送液の自動化をさらに進化させ、誤操作や誤装填を無くす画期的なシステム
(ドラム装填/液種認識、配管接続、攪拌機挿入の自動化提案)

AI搭載リードフレーム自動検査装置
再検査ゼロへ。AIが変える外観検査の新基準。
その他、半導体製造業向け各種商材を展示予定

NYS
株式会社西村ケミテック



出展のご案内

SEMICON Japan 2025

会期:2025.12.17(水)~19(金) 会場:東京ビッグサイト 東6ホール[E6431]

先端の半導体パッケージを支える
オクノの表面処理薬品

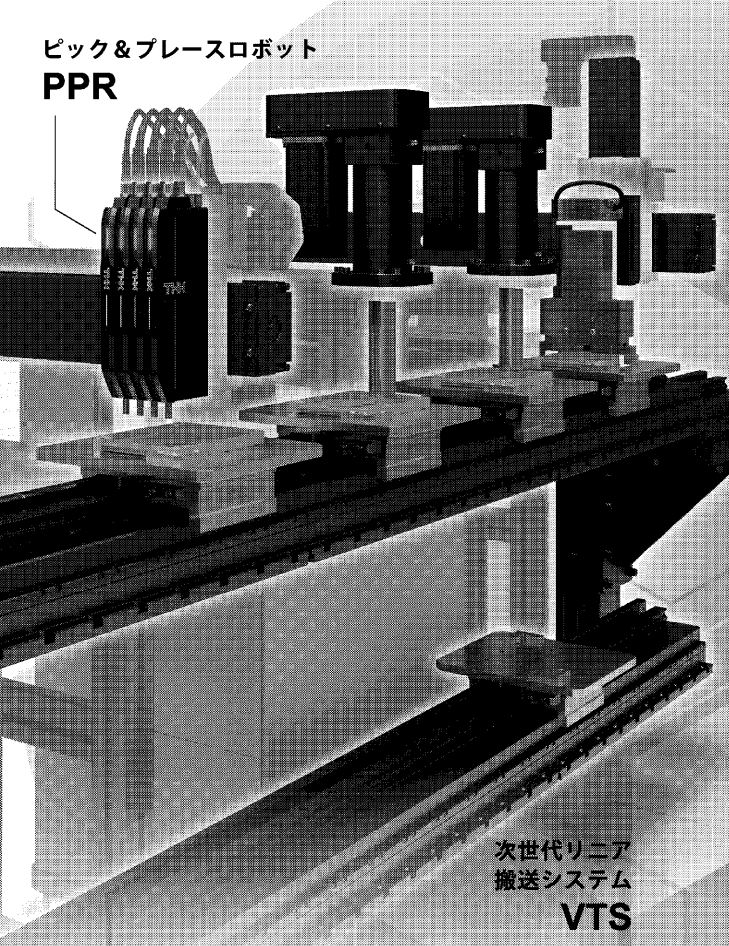
半導体ウエハ用めっき薬品・めっき装置
ガラス基板向けめっき薬品
パッケージ基板向けめっき薬品
パワーデバイス向けめっきプロセス
プリント配線板向け最新表面処理

妄想をカタチに。TORYZA

TOP 奥野製薬工業株式会社

www.okuno.co.jp

ピックアップロボット
PPR



THK

最先端の自動化
期待を超える 革新への“動き”

次世代リニア
搬送システム
VTS

SEMICON JAPAN に出展いたします
会場 東京ビッグサイト 小間番号 E4745

特殊環境用
低透磁率 LM ガイド
HSR-M3

THK株式会社 マーケティングPR統括部
03-5730-3845 www.thk.com

半導体製造向け製品・サービス特集はこちら

THK SEMICON



提案する化学。

SEMICON Japan 2025 当社ブース【W3003】
2025年12月17日～12月19日
【会場】東京ビッグサイト 是非お立ち寄りください

化学の可能性は常に無限。
私たちは化学の力で不可能の壁を越え、
かつてないソリューションをお届けします。

日本触媒

最先端の半導体工場ガス配管ニーズに対応できる
超高清浄 KUZE - EPコイルチューブ

1.飛躍的な信頼性の向上
溶接箇所直径の1/25に出来るので配管の信頼性が飛躍的に高まります

2.トータルコストの削減
溶接箇所の大規模削減により施工期間の短縮が可能です

3.新型伸管機による直進性の著しい改善
直進精度の高い新型伸管機を開発しました

大幅な溶接フリー化
溶接時の粒子発生を低減や、組立時における混入物の防止

より洗練された長尺EP管

信頼性UP耐食性UP
溶接による耐食性の劣化、溶接欠陥のリスクの減少

作業工数削減による工期短縮
コイル専用ボータプル伸管機の使用により、さらに短縮

■製造寸法 SUS316L TP-SC EP ○:製造在庫 ※要相談

外径 (mm)	内厚 (mm)	標準製造長さ (m)	内表面粗さ 保証値
6.35	1.0	30	○
9.53		50	○
12.70	1.0	100	○
19.05	1.24	※	※
	1.65		

SEMICON JAPAN 東6ホール No.6402

お問い合わせ 【羽咋工場】石川県羽咋市新保町下61
TEL (0767) 22-0399 FAX (0767) 22-1150

株式会社 久世ペロローズ工業所 【本社・本社工場】石川県河北郡津幡町南中条174-1
TEL (076) 289-4740 FAX (076) 289-2136
https://www.kuze.com/

戦略・ビジネス・人材・技術—ここに集う

SEMICON JAPAN

クラボウ

クラボウは「計測」「高機能フィルム」「機能樹脂」「フィルター」の4分野で顧客の課題解決につながる製品技術を提供する。計測分野は光の吸収原理の応用と、インライン設計で連続測定を実現した薬液成分濃度計「ケミカルライザー」シリーズを紹介。ウェハー処理中の変化を監視と薬液使用量の削減につながる「In-line」反射光モニタ」を参考出品する。

高機能フィルムは半導体工程用「オレフィンフィルム」や、透明で視認性が高い耐熱保護テープ用の「EXPEEK」(エクスピック)などを展示。機能樹脂分野は少量の試作・開発から量産まで対応できる設備体制をアピールする。

THK

THKは半導体チップの生産能力向上に役立つ「高加減速対応・低振動ミニチュアLMガイド」や、高温下や高耐食などが求められる特殊な環境下で使用可能な「特殊環境用LMガイド」を展示する。

また、高速・高加減速で自在な搬送を実現する「次世代リニア搬送システム」や高精度カセンサー内蔵のピックアップ&プレスロボット「PR」などのデモンストレーションも実施。設備総合効率(OEE)の最大化に貢献するIoTサービス「OMNIEDge」も紹介する。

培ってきたノウハウで、顧客ニーズに合わせたソリューションを提案し、「最先端の自動化」の実現に貢献していく。

久世ペロローズ工業所

久世ペロローズ工業所は金属塑性加工の技術を駆使し、高純度ステンレス鋼シームレススクリーンパイプ・チューブ・継ぎ手、ペロローズ(伸縮管継ぎ手)などを供給する。一連の製品は国内外の半導体工場の高純度ガス配管や機器に採用されている。

近年は溶接工数の減少による工期の短縮や配管の信頼性向上を目的に、溶接箇所を直管使用時と比べ最大25分の1まで削減できる「EPコイルチューブ」の需要が高まっている。同製品は100分最長100分以内の面を特殊電解研磨(EP)処理し、精密洗浄した。外径6・35・19・05・1.0・0.7・0.5・0.3・0.2のサイズに対応する。ダブルメルト(二重溶接材)での製造もできる。

トヨックス

トヨックスは半導体製造プロセス向けに「ボース配管安心セット」を出展する。同社の「トヨコネクタ」は流体搬送における液漏れや、ボース抜けのリスクを大幅に低減する独自のMS構造を採用。メンテナンス負担と生産停止のリスク軽減に貢献する。

特に、UL規格に準拠した難燃性の「フレキシブルロックハイブリッドULボース」と組み合わせることで、難燃性と配管の安全性を両立したソリューションを提案。製造現場の安定稼働と安全対策を強力にサポートする。同ボースは主に冷却水用としての使用を想定。難燃断熱材と難燃ボースを一体化した構造のため、従来必要だった断熱材を被覆する作業からも解放される。

日本触媒

日本触媒は三次元装架材料、ウェットプロセス用薬液の高機能化、フォトリソグラフィ向け新素材をテーマに、独自の「ゲミストリック」により新たな機能を付与する新規素材とソリューションをアピールする。

展示ブースではシリカ微粒子や機能性モノマー技術、水溶性各種化学薬品を紹介。次世代半導体デバイスの進化だけでなく、生産効率の改善、信頼性向上、微細加工の高精度化にも寄与するソリューションを提案する。

半導体製造技術、装置および半導体用材料などのエレクトロニクス製造サプライチェーンとの協創を通して、顧客が目指す新たなテクノロジーの実現に貢献する。

レーザータック

レーザータックはウェハーファブでの極端紫外線(EUV)マスクの受入検査や定期的な品質検査向けに、アクティビックEUVパターンマスク欠陥検査装置「ACTIS A200H-ETシリーズ」を製品化した。

光学設計の最適化と検査システムの刷新で2019年発表のACTIS A150と比較して、検査速度を3倍に向上させた。また、EUVマスク運用中に発生するすべての転写性欠陥も検出できる。マスク検査コストの低減と高い生産性でウェハーファブの歩留まり向上に寄与する。このほか、ウェハー関連検査装置や、11月に発表した超短パルスレーザー励起顕微鏡「OPTELICS UXM」なども紹介する。

JSR

JSRは半導体産業の機能性材料のリーダーカンパニー。デバイスの製造プロセス全体にわたる幅広いソリューションを提供。展示会では前工程から後工程まで幅広い製品をラインアップする。最先端の極端紫外線(EUV)メタルオキシドレジスト(MOR)をはじめ、ポスト化学機械研磨(CMP)洗浄剤や機能性洗浄剤、原子層堆積(ALD)/化学気相成長(CVD)向けプリカライザー、めっき用厚膜フォトリソ resist、感光性絶縁材料など、回路形成や高密度実装に欠かせないさまざまな高性能材料を紹介。フラットレンズや磁気抵抗変換型メモリ(MRAM)向け材料など、次世代技術に対応する製品も展示予定。

ラヤマパックス

ラヤマパックスは半導体製造装置向けフッ素樹脂加工と精密切削加工のほか、300mmウェハー用ソフトトレイ製造などラヤマグループの取り組みを紹介する。

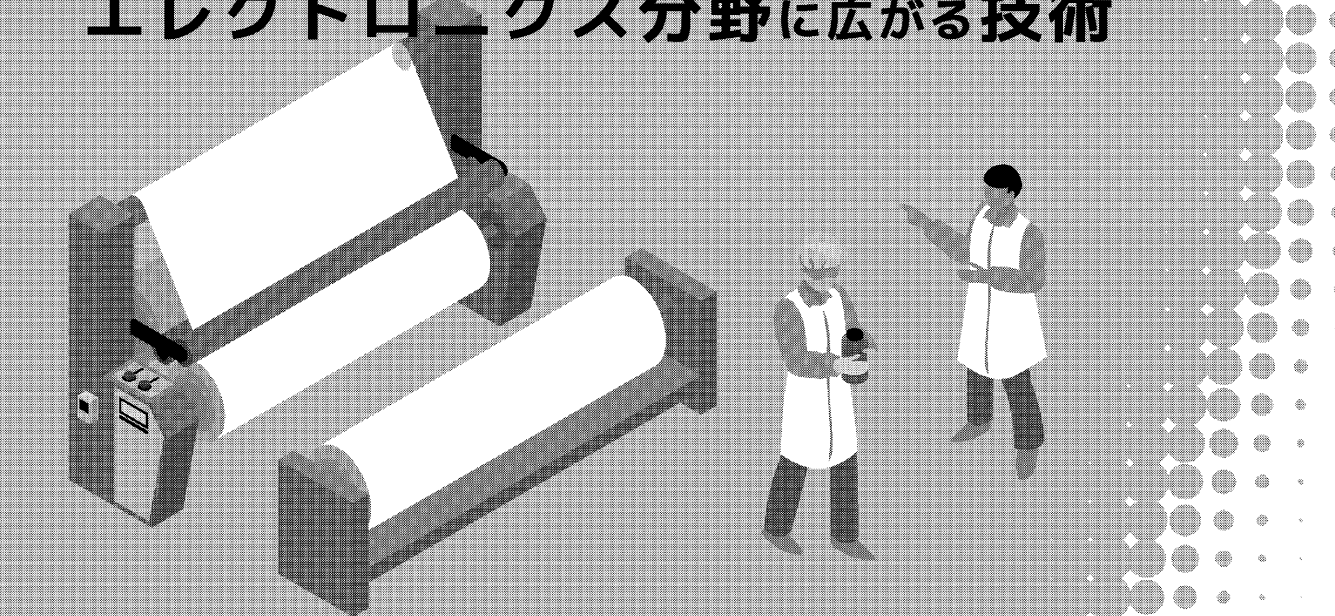
フッ素樹脂専用機による射出成形(型締め圧力110MPa)と金型の設計製造は、培ったエンジニアリングとプラスチックの成形技術と金型技術を昇華させ手がけている。金型のみ販売は成形条件を添付可能。

同時5軸15台を含むマシニングセンター76台、数値制御(NC)旋盤10台でアルミや真鍮、鉄、難削材に高精度の部品加工も行い、半導体製造装置にアプローチする。またフッ素樹脂の切削加工も事業範囲に加えた。

KURABO

SEMICON Japan 2025 に出展！
東5ホール 小間番号：E5632

繊維で培った クラボウだから できる
エレクトロニクス分野に広がる技術



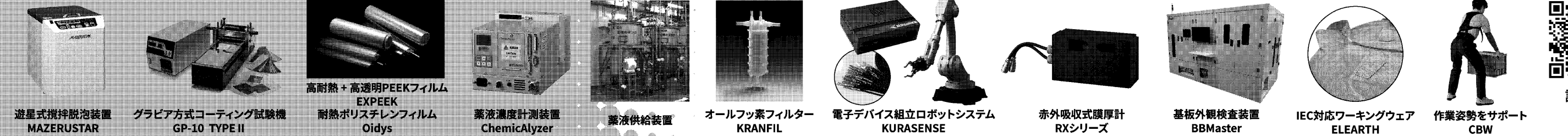
細やかな
対応力

課題の抽出から、ニーズヒアリング、アフターフォローまで、一人の営業担当が誠実にお応えする One to One コミュニケーションのサポートがポリシーです。

確かな
技術力

長年の歴史の中で培われた、当社独自のコア技術。それらを駆使した高精度なオンリーワン製品と、カスタマイズ技術でお客様ニーズに応えます。

細やかな対応力 × 確かな技術力



遊星式攪拌脱泡装置 MAZERUSTAR

グラビア方式コーティング試験機 GP-10 TYPE II

高耐熱・高透明PEEKフィルム EXPEEK
耐熱ポリスチレンフィルム Oidys

薬液濃度計測装置 ChemicAlyzer

薬液供給装置

オールフッ素フィルター KRANFIL

電子デバイス組立ロボットシステム KURASENSE

赤外吸収式膜厚計 RXシリーズ

基板外観検査装置 BBMaster

IEC対応ワーキングウェア ELEARTH

作業姿勢をサポート CBW

詳しくはこちら

総務部 コーポレートコミュニケーション課 〒541-8581 大阪市中央区久太郎町2-4-31 Tel : 06-6266-5053 Mail : pr_grp@kurabo-grp.com Url : https://www.kurabo.co.jp/

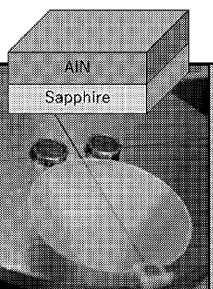
パワー半導体のコスト削減・環境負荷の低減・性能向上を実現

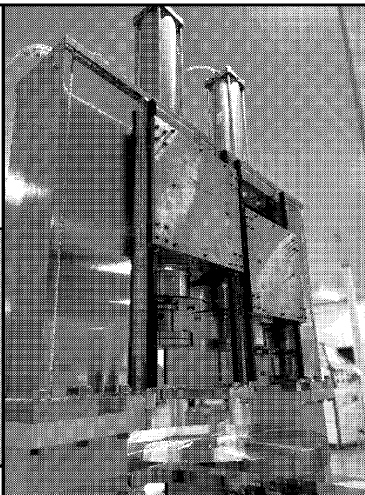


CARE-TEC®
Atomically Flat Surface

単結晶窒化アルミニウム(AIN)と同等結晶を実現
サファイア基板上AINテンプレート

世界最高級品質の結晶性



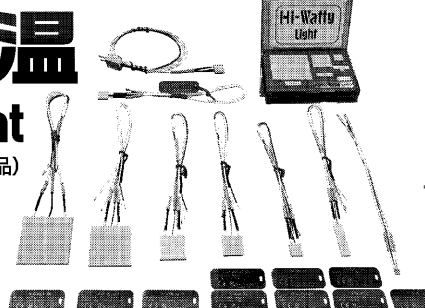


株式会社 東邦鋼機製作所 TEL:059-365-4381 FAX:059-365-4383
〒512-8062 三重県四日市市黄金町38番地 <https://tohokoki.jp/>

最高500℃まで
高速昇温
Hi-Watty Light

純日本製 窒化アルミヒータ（標準品）

5mm～50mmのサイズ
をラインアップ
短納期対応可能



WEX-SG
1.5Wシールドタイプ

WEX-SG
1.125Wシールドタイプ

WEX-SS

SEMICON JAPAN

12月17日(水)～19日(金)
@東京ビッグサイト
東4ホール「小間番号：E4622」

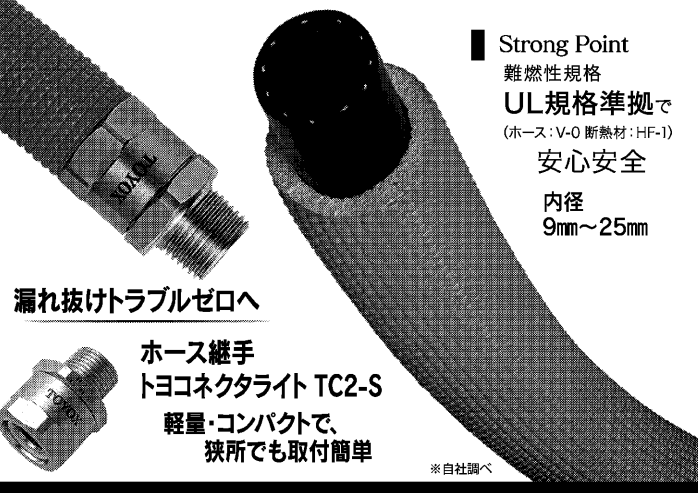
<https://www.watty.co.jp>

ワッティー 株式会社
熱システム事業部 相模原事業所 〒252-0331 神奈川県相模原市南区大野台4-1-71 TEL.042(704)5360 FAX.042(704)5354 E-mail:info@watty.co.jp

難燃断熱材×難燃ホース

業界初 難燃断熱材一体型ホースで被覆する作業ゼロへ

冷却水用(結露防止) フレームブロックハイブリッドULホース



Strong Point
難燃性規格
UL規格準拠で
(ホース・V-0 断熱材：HF-1)
安心安全
内径
9mm～25mm

漏れ抜けトラブルゼロへ

ホース継手
トコネクタライト TC2-S
軽量・コンパクトで、
狭所でも取付簡単

※自社調べ

TOYOX トヨックスプース W3861

SuperTHEATER						(無料：西4ホール内)		このほかにも多数のセミナーあり 詳細は下記のコードへ	
17日	10:00	グローバル半導体エグゼクティブサミット AI x サステナビリティ x 半導体	18日	10:15	AI 最前線 技術革新が切り開く新時代	19日	10:30	世界に貢献する日本の先端半導体戦略 日本半導体産業の発展にむけて ステップ1-2-3とその先を語る	
	12:45	次世代半導体技術1 ～デバイス編 未来を造る半導体革命		12:20	生成AI ～政策・ハード設計・プラットフォーム・アプリケーション 無限の創造と可能性		12:30	世界市場における 日本半導体産業の競争力 日本の半導体戦略を問う —政策・産業構造・地政学から読み解く！	
	15:00	次世代半導体技術2 ～装置材料編 未来を造る半導体革命		14:30	Advanced Packaging and Chiplet Summit 2025 未来をつなぐチップレット：光・車・AIが描くサステナブル社会		【ブランドフィナーレ】 半導体サプライチェーンの未来：グリーン化と持続可能性への挑戦		
							14:30	持続的成長を本物に SEMI ジャパン代表 浜島 雅彦	
							14:35	持続的成長へー 世界と共に築く日本半導体の未来 マッキンゼー・アンド・カンパニー 日本オフィス パートナー 土谷 大	
							15:05	グローバル・ハイテク製造業における脱炭素化への主要アプローチ Apple Head of Strategy, Environment & Supply Chain Innovation ベスマ・アルジャーブ	
							15:35	アブライド マテリアルズ 社長 兼 CEO ゲイリー・ディッカーソン	
							16:05	コラボレーションが実現する Digital & Green の未来 東京エレクトロン 代表取締役社長・CEO 河合 利樹	※敬称略

SEMICON JAPAN

12月17日ー19日 / 東京ビッグサイト

コフロック

コフロックはメタルシールマスフローコントローラー「ST1500」と、カルマン渦流量計「FML3000」を出展する。
「ST1500」は圧力変動に伴うガス流量の乱れを抑えるPI機能の搭載や、EthernetCATなど産業ネットワーク規格への対応など、半導体製造プロセス向けに開発した。PI機能を省いた低コスト仕様など、バリエーションも増やしている。
「FML3000」は接液部がフッ素樹脂(PFA)で、耐薬品性に優れた液体用流量計。温度センサーを内蔵し、液温変化時も精度よく流量を計測できる。販売が好調な中、顧客の要望などを反映したラインアップ拡充の検討も進んでいる。

坂口電熱

創業102年を迎えた坂口電熱は産業用ヒーターの開発から設計・製造・販売まで幅広く手がける。
ヒーター、温度センサー、温度調節器、断熱材など、加熱に関するプロセスに必要な製品を豊富にそろえる。特注品を含め、顧客ニーズにあった最適な製品を提案することを強みとしている。
展示会では保温効果の高い断熱材とシャケットヒーター、省スペースで局所加熱に適した小型セラミックヒーター、米国の第三者認証規格「UL」対応の面状発熱体、カートリッジヒーターなどを展示する。

ワッティー

ワッティーは半導体製造装置の後工程において、採用実績が伸長している急速昇温対応セラミックヒーター「Hi-Watty」シリーズを出品する。
プロセスガス加熱器のラインアップとして、集積化ガスシステムに直接搭載可能な「WEX-SG」、低流量対応の「WEX-SS」、ワンパスでの液体加熱に特化した「高圧CO₂加熱器」のほか、薬液用加熱器も展示し、幅広いプロセスニーズに対応する。
従来の主力製品であるシリコンババーヒーターポリイミドヒーター、マイカヒーターのほか、配管加熱用のマントルヒーター、ハイジートレスヒーターを出品。熱電対、白金測温抵抗体などの温度センサーも展示する。

東邦鋼機製作所

東邦鋼機製作所は化学機械研磨(CMP)パッド加工装置メーカーとして、国内外から高い評価を得ている。CMPパッドの品質は半導体の性能を左右する。同社はインド市場をはじめ、さらなる販路開拓を進める。
また大学と連携し先端技術開発にも取り組む。大阪大学の山内和人特任教授らと、水を加え液として炭化ケイ素(SiC)表面欠陥を除去できる次世代半導体基板平坦加工装置「CARE-TEC」を開発した。三重大学の三宅秀人教授と実用化した単結晶窒化アルミニウム(AIN)と同等性能を持つサファイア基板上AINテンプレートの技術に応用し、次世代高速通信用のテンプレートも開発している。

コンプロフェ

Conprofeは超音波CNC工作機械と主要部品の専門メーカー。エンジニアリングプラスチック、複合材料、難削材の超深微細加工と高精度加工に効率的なソリューションを提供する。
ビッカース硬度(HV)3150のCVD炭化ケイ素シャワーヘッド加工では、入口の直径1.0mm、出口0.5mmの段付き穴加工で1穴当たり5分58秒を実現。
真直度は直径1.0mmが0.033mm以下、0.5mmが0.039mm以下、同軸度0.026mm以下、ワーク1個あたり加工コストは約33万円。海外にシールルームハットと事務所を五つ構え、幅広くアフターサービスも展開する。

CONPROFE 汇専

匯專超音波加工ソリューション

硬脆材料、エンジニアリングプラスチック、金属材料などの
超深微細穴に対応

高効率、高安定性、低コスト!

400件以上の超音波特許を持ち、
インテリジェント超音波加工システムの販売実績は 20万/セットを超える

CVD炭化ケイ素シャワーヘッド(HV 3,150)

① D1.0/D0.5mm段付き穴の一穴当たりの加工時間が5分58秒と47.8%短縮

② 刃物寿命は160%向上、加工コストは約33万円と50%低減

匯專の小間番号
W2701
Tel/WhatsApp: +86-138 2607 9999
E-mail: sales-international@conprofetech.com
Website

一体型超音波スピンドル

超音波常温圧入式ホルダー
(振れ精度≤2μm)

段付き穴
同軸度
≤0.026mm
面粗さSa 0.036μm

穴口部チッピング
≤0.02mm

最大回転速50,000rpm
ダブルスピンドルに対応

特許製品
高効率・高速PCDマイクロドリル
刃物寿命は520穴以上
加工直径
D0.1mm

超音波彫刻・フライスマシニングセンター ULWシリーズ